

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2023 年 11 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	11 月 3 日 09:00-10:00, 10:00-11:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00, 16:00-17:00 Allianz Global Investors、Boston Partners、Brilliance、Cephei Capital、Dymon Asia Capital、Fountain Cap、Grand Alliance Asset Management、Heartland Capital、LyGH Capital、Manulife、Mirae Asset Global Investment、MW、Pinopint、Turiya、Pictet Asset、Prime Brokerage Sales Prospects、财通基金、汇添富、咏鸣投资、国海电子、申万宏源 11 月 9 日 9:30-10:30, 10:00-11:00, 13:30-14:30, 14:30-15:30, 16:00-17:00 交银施罗德、弘则弥道投资、建信保险、华金证券、国源信达、富荣基金、歌斐资产、鹏华基金、海雅金控、长城基金、东方证券、慧创蛛祥私募、易同投资 11 月 17 日 9:00-10:00, 10:30-11:30, 13:00-14:00, 14:30-15:30, 16:00-17:00 摩根大通、富达国际、Capital International - United States、D.

	E. Shaw & Co 、 Franklin Templeton Investment Funds、 Point 72、UG、凯基证券
时间	11 月 3 日 09:00-10:00, 10:00-11:00, 13:30-14:30 , 15:00-16:00, 16:00-17:00 11 月 9 日 9:30-10:30, 10:00-11:00, 13:30-14:30 , 14:30-15:30, 16:00-17:00 11 月 17 日 9:00-10:00, 10:30-11:30, 13:00-14:00 , 14:30-15:30, 16:00-17:00
地点	无锡、深圳、香港
上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子执行董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子董事会办公室副主任
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问公司如何展望 2024 年市场景气度？ 答：根据行业专业机构预测以及公司市场、客户端的反应，预计 2024 年半导体行业会有好转，相比 2023 年会有所增长。 问题二：请问未来如何规划下游终端领域的结构？ 答：公司根据市场需求适时调整终端结构、客户结构及产品结构。目前新能源汽车、太阳能光伏、工控等领域是公司重点发力的方向，市场和客户拓展也有显著成效。公司产品与方案板块下游终端应用中，新能源及汽车电子领域产品占比接近 40%，加上工业设备、通信设备等产品占比接近 70%。同时，消费电子的市场也很广阔，消费升级也有很多机会，公司也会持续关注消费电子领域的发展。 问题三：请问公司两条 12 吋产线的主要产品及目前进展？ 答：重庆 12 吋产线聚焦功率器件，产品主要是 MOSFET 和 IGBT 等，目前产品验证速度和产品爬坡进度按计划进行。 深圳 12 吋产线预计 2024 年底通线，聚焦 40-90nm 特色模拟

	功率集成电路产品和 MCU 产品。 问题四：请问公司两条 12 吋产线的产品应用的定位是什么？ 答：重庆、深圳 12 吋产线产品主要聚焦汽车、工控、新能源等中高端领域。 问题五：在行业波动期，公司毛利率相对同行来说，表现非常稳定，是如何做到的？ 答：公司毛利率稳定得益于公司从五年前就开始布局调整产品结构、产能结构、客户结构，较早进入新能源以及汽车电子领域。同时公司注重产品及工艺平台的核心竞争力、关注客户需求、积极布局产线资源，产能利用率保持高位。我们认为在好的赛道上，可以尽量降低周期下行影响，也希望在周期向上的阶段，通过 12 吋释放产能、重点产品 IGBT、第三代半导体、传感器等市场份额的提升，更好的抓住发展机遇。 问题六：请问公司有什么策略保持 IGBT 的增长？2023 年 IGBT 产品业绩指引是什么？ 答：公司不断丰富 8 吋 IGBT 产品系列以及 IGBT 模块产品规模上量，并加快光伏、储能、工控和汽车电子等高端应用领域持续突破，有序推进 IGBT 车规级产品进入汽车电子核心应用。同时，公司将进一步加大 12 吋 IGBT 工艺技术和产品研发投入。2023 年公司 IGBT 产品较去年仍会保持高速增长。 问题七：请问公司碳化硅产品结构及进展情况？ 答：公司碳化硅产品包括 SiC MOSFET、SiC JBS 以及 SiC 模块产品，其中 SiC MOSFET 在销售中的比例提升至 50%以上，在新能源汽车、光伏储能、工业电源等领域规模上量。 问题八：请问公司氮化镓产品进展情况？是否涉有做外延？ 答：氮化镓产品在通讯、工控、照明和快充等领域实现多家行业头部客户合作，产品进入批量供应阶段，营收同期大幅
--	---

	增长。氮化镓的外延制造是较为核心的技术，公司自主研发生产硅基氮化镓外延片。 问题九：目前公司自用和外部代工是如何做产能分配的？ 答：6 吋产线自用和外部客户代工比例基本 6:4；8 吋产线有 2 条，无锡 8 吋产线约 80%用于外部客户，重庆 8 吋产线全部自用；重庆 12 吋产线规划用于自有产品。 问题十：请问公司各产线的产能是怎样的？ 答：公司 6 吋生产线月产能逾 23 万片，8 吋生产线月产能逾 14 万片，重庆 12 吋生产线一期产能规划 3-3.5 万片，目前按照预期推进，处于产能爬坡阶段。 问题十一：请问公司目前封测的产能及后期规划？ 答：公司目前封装能力月产能 8.7 亿颗，未来公司将通过重庆封测基地建设，全面覆盖模块级先进封装、晶圆级先进封装、面板级先进封装、第三代半导体封装等技术领先门类，有序推进封装工艺升级。 问题十二：从前三季度看，公司利润端与同行比，表现非常不错，但同比有下降，其中具体原因可以分析一下吗？ 答：公司前三季度，与同行企业比，与半导体行业数据比，跑赢大势，但同比有下降，一方面，来自市场下行带来的价格压力；另一方面，费用端增长，公司有多个研发项目，研发投入力度不断加强，同时深圳 12 吋线、封测基地等新业务逐步开展。科技企业，投资研发也是投资未来，现在做产品研发、重点项目建设，是为了更长远的布局，为未来公司高质量可持续成长打基础。 问题十三：请问公司 2023 年资本开支使用情况？2024 年资本性支出是否会继续维持？ 答：2023 年公司资本开支主要用于深圳 12 吋生产线及重庆先进功率封测基地的建设。2024 年深圳 12 吋产线仍然处于投资
--	---

	周期，同时公司会持续加大收购兼并力度。 问题十四：请问 2023 年折旧是否会增加，主要是哪些项目？ 答：公司 2023 年折旧较 2022 年将有小幅上升，主要体现在封测基地、掩模产能提升等项目上。 问题十五：请问如何展望 2024 年产能利用率？ 答：产能利用率对于公司具有较高优先级，公司将结合市场情况不断优化产品结构，增加中高端产品的产能布局，明年保持较高的产能利用率仍是我们的目标。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月